

证券代码：600460  
债券代码：122074

股票简称：士兰微  
债券简称：11 士兰微

编号：临 2016-005

## 杭州士兰微电子股份有限公司

# 关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8 英寸芯片生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资项目名称：8 英寸集成电路芯片生产线。
- 投资金额：本次公司拟增资 2 亿元人民币、国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟增资 6 亿元人民币。
- 本次投资尚需要提交公司股东大会审议通过。

## 一、投资概述

### （一）投资的基本情况

1、为抓住机遇加快公司集成电路芯片生产线的升级，提高公司产品的综合竞争能力，根据 2015 年 4 月 22 日召开的 2014 年年度股东大会上审议通过的《关于拟投资建设 8 英寸集成电路芯片生产线的议案》（详见公司临 2015-015 号和临 2015-023 号公告），公司正在投资建设一条 8 英寸集成电路芯片生产线（以下简称“本项目”或“该项目”），该项目正处于主体厂房建设和设备采购阶段。

2、资金安排：总投资 10 亿元人民币，本次共增资 8 亿元人民币，其中本公司增资 2 亿元人民币，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）增资 6 亿元人民币。

3、实施主体：本项目目前由本公司的控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）实施。待本次投资事项全部完成后，本项目的实施主体将由士兰集成整体变更为杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”），士兰集成在此之前已经形成的本项目资产将转移至士兰集昕。

（二）公司于 2016 年 2 月 3 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8 英寸芯片生产线的议案》，该事项尚需经公司股东大会批准。

（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、增资各方基本情况及增资方式

### （一）增资方式

1、集成电路产业基金拟出资 2 亿元人民币，本公司拟出资 2 亿元人民币，共同增资杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）。目前集华投资为本公司全资子公司，注册资本为 1,000 万元人民币。增资后集华投资注册资本将增加到 41,000 万元人民币。

集华投资增资前后出资情况对比：

单位：人民币万元

| 增资前  |       |      | 增资后      |        |        |
|------|-------|------|----------|--------|--------|
| 股东名称 | 出资额   | 出资比例 | 股东名称     | 出资额    | 出资比例   |
| 士兰微  | 1,000 | 100% | 士兰微      | 21,000 | 51.22% |
|      |       |      | 集成电路产业基金 | 20,000 | 48.78% |
| 合计   | 1,000 | 100% | 合计       | 41,000 | 100%   |

2、集成电路产业基金拟出资 4 亿元人民币，增资后的集华投资拟出资 4 亿元，共同增资士兰集昕。目前士兰集昕是士兰微与士兰集成共同出资设立的控股子公司，注册资本为 2,000 万元。增资后士兰集昕注册资本将增加到 82,000 万元。

士兰集昕增资前后出资情况对比：

单位：人民币万元

| 增资前  |       |      | 增资后      |        |        |
|------|-------|------|----------|--------|--------|
| 股东名称 | 出资额   | 出资比例 | 股东名称     | 出资额    | 出资比例   |
| 士兰微  | 1,800 | 90%  | 集华投资     | 40,000 | 48.78% |
|      |       |      | 集成电路产业基金 | 40,000 | 48.78% |
| 士兰集成 | 200   | 10%  | 士兰微      | 1,800  | 2.20%  |
|      |       |      | 士兰集成     | 200    | 0.24%  |
| 合计   | 2,000 | 100% | 合计       | 82,000 | 100%   |

3、待士兰集昕上述增资全部完成后，公司 8 英寸集成电路芯片生产线项目的实施主体将由士兰集成整体变更为士兰集昕，士兰集成在此之前形成的该项目资产将转移至士兰集昕。

## （二）增资各方基本情况

### 1、国家集成电路产业投资基金股份有限公司

- （1）公司名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司
- （2）成立时间：2014 年 9 月 26 日
- （3）注册地址：北京市市辖区经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室
- （4）注册资本：9,872,000 万元
- （5）法定代表人：王占甫
- （6）公司类型：股份有限公司（非上市）
- （7）经营范围：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询
- （8）增资主体的股东情况：财政部（25.95%）；国开金融有限责任公司（23.07%）；

中国烟草总公司（14.42%）；北京亦庄国际投资发展有限公司（7.21%）；中国移动通信集团公司（7.21%）；其他股东合计 22.14%。

## 2、杭州集华投资有限公司

- （1）公司名称：杭州集华投资有限公司
- （2）成立时间：2015 年 12 月 4 日
- （3）注册地址：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 9 号楼 1 楼。
- （4）注册资本：1,000 万元
- （5）法定代表人：陈向东
- （6）经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（以法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- （7）增资主体的股东情况：本公司持有集华投资 100%的股权。
- （8）截至 2015 年 12 月 31 日，集华投资总资产为 1,000 万元，负债 0 万元，净资产 1,000 万元。2015 年营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（以上数据未经审计）
- （9）待本次共同投资事项完成后，集华投资的注册资本将由 1,000 万元增加至 41,000 万元。

## 三、实施主体的基本情况

- 1、公司名称：杭州士兰集昕微电子有限公司
- 2、成立时间：2015 年 11 月 4 日
- 3、注册地址：杭州下沙经济技术开发区东区 10 号路 308 号 13 幢
- 4、注册资本：2,000 万元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：生产、销售：8 英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）。
- 7、投资主体的股东情况：本公司持有士兰集昕 90%的股权，本公司重要子公司士兰集成持有士兰集昕 10%的股权。
- 8、截至 2015 年 12 月 31 日，士兰集昕总资产为 1,998.5 万元，负债 0 万元，净资产 1,998.5 万元。2015 年营业收入 0 万元，净利润-1.5 万元。（以上数据未经审计）
- 9、待本次共同投资事项完成后，士兰集昕的注册资本将增加至 82,000 万元

## 四、投资事项对上市公司的影响

1、如本投资项目顺利实施，将有力地提升公司的制造工艺水平，进一步缩小与国际同类型半导体企业之间的差距；能够有力地强化公司的盈利能力，提升公司的综合竞争能力。

2、本次引入集成电路产业基金为 8 英寸生产线的投资方，为 8 英寸生产线的建设提供了重要的资金保障，有利于加快 8 英寸生产线的建设和运营。

## 五、投资的风险及应对

1、可能存在市场风险，导致产品竞争力下降

应对措施：做好前期的市场分析，加快新产品新工艺的开发，提高核心竞争力。

2、可能存在技术风险

应对措施：一方面，士兰体系内目前已经在五、六英寸集成电路芯片生产线上积累了丰富的技术和管理经验，培养了一大批技术和管理骨干；另一方面公司将继续积极引进优秀的技术人才提升自身技术能力。

3、本投资事项尚需要提交公司股东大会审议通过。

## 六、其他说明

因本次投资事项周期较长，公司将根据投资事项和项目实施的不同进展，分阶段做好后续的信息披露。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016年2月4日